



電気・電子材料技術セミナー Insulation 2016

— 環境から先端技術まで、次の時代を幅広く支える電気機能材料 —
自動車・鉄道技術から樹脂技術まで最新技術を紹介します

主催：電気機能材料工業会 技術部会

協賛：(一社)電気学会 (一社)日本電機工業会 (一社)日本電線工業会
(予定 合成樹脂工業協会 日本粘着テープ工業会 日本接着剤工業会
含む) (一社)電子情報技術産業協会

日時：2016年 11月24日(木) 9:40~17:00 17:00~18:00 無料懇親会
11月25日(金) 9:30~15:15

場所：亀戸文化センター(カメラプラザ 3階)(JR 亀戸駅前)
(併設展示会：カメラプラザ 2階 大研修室)
東京都江東区亀戸 2-19-1

交通：JR 総武線 亀戸駅 北口下車 徒歩 約2分

参加費 会員 10,000円(講演予稿集代金を含む)
学生 1,000円(同上 受付で学生証を提示して下さい)
その他 12,000円(講演予稿集代金を含む)
参加費は、当日受付もしくは、事前振込みにて、お支払いください。
(別途、5名以上の申込の場合には、割引もありますので、事務局へご相談下さい)
講演予稿集は、当日会場でお受け取りください。

参加及び講演予稿集の申込み

下記申込み用紙に必要事項を記入し、郵送又はFAXでお送りください。
同様な内容を、電子メールでお送り頂いても結構です。

申込先 電気機能材料工業会 事務局(石川)
〒130-0014 東京都墨田区亀沢 4-5-6 電話 03-3829-4241 FAX 03-3829-4243
E-mail: jeia@vesta.ocn.ne.jp, URL: <http://www.jeia.jp>

..... きりとり線

電気機能材料工業会 行
FAX 03-3829-4243

電気・電子材料技術セミナー Insulation 2016 参加及び講演予稿集申込書

2016年 月 日

氏名	勤務先、所属、住所、電話番号、Eメールアドレス	参加申込	* 予稿集

* 参加せず、予稿集だけを予約申し込みの場合は、予稿集の欄にだけ(○)を記入ください。

プログラム

11月24日(木)

9:40～9:50 挨拶 電気機能材料工業会 理事長 池田 聡

9:50～10:30 **【一般講演】 先端電子デバイス分野に対応する多彩な
高性能エポキシ樹脂・硬化剤光酸発生剤の技術動向**
DIC 株式会社 佐藤 泰 様
エポキシ樹脂硬化物は、エレクトロニクス材料など多くの先端分野で広く使われる重要素材である。先端電子デバイス分野からの高性能化要求は、益々高度化し、且つ多様化する傾向が強い。本セミナーでは、当社が開発した多彩な高性能エポキシ樹脂・硬化剤について紹介する。

10:35～11:55 **【特別講演】 台湾工業技術研究院のご紹介**
～今後発展が期待される分野に向けた機能材料の開発状況を中心に～
台湾工業技術研究院 李 宗銘 様
今後発展が期待される、ハイブリッド複合材料、バッテリー用材料、バイオマス系材料、新世代の通信システムとパワーエレクトロニクスのための新誘電体材料、環境対応の機能材料、可撓性電子部品用材料などの材料とその開発事例を紹介する。更には、台湾工業技術研究院で計画している、今後の開発プロジェクトについても説明する。

11:55～12:25 併設展示会のご案内

12:25～13:55 — 休憩（昼食及び展示会見学） —

13:55～15:15 **【特別講演】 次世代の革新的・高機能型電力機器開発に向けた絶縁材料技術**
～傾斜機能材料と極低温絶縁材料～
名古屋大学 早川 直樹 様
次世代の革新的・高機能型電力機器開発に向けて、誘電率や導電率の空間分布を可変とする傾斜機能材料（FGM）のGISスパーサ周辺の電界制御・緩和技術、超電導電力機器の合理的・実用的絶縁設計に資する極低温絶縁材料技術について述べる。また、これらのトピックに関連するCIGRE、電気学会、NEDO等の活動状況を紹介する。

15:15～15:30 — 休憩 —

15:30～16:50 **【特別講演】 In situ 生成改質剤ポリマーによる熱硬化性樹脂の高性能化**
横浜国立大学 大山 俊幸 様
改質剤ポリマーをモノマーの状態でも未硬化の熱硬化性樹脂に添加し、樹脂の硬化と並行して改質剤モノマーのラジカル重合を行うことにより樹脂硬化物の強靱化を達成する「in situ 重合法」について紹介する。In situ 重合法の適用により、エポキシ樹脂をはじめとする様々な熱硬化性樹脂硬化物の強靱化が可能となる。

17:00～18:00 無料懇親会（於：2階 大研修室）

11月25日(金)

- 9:30~10:10 **[一般講演]** **シラン・シリコンと樹脂用添加剤**
東レダウコーニング(株) 吉沢 武 様
シリコン（ポリジメチルシロキサン）に代表されるケイ素ポリマーは耐熱性、化学的安定性等に優れており、またモノマーであるシランカップリング剤はその反応性を利用して強化プラスチック等の分野で幅広く利用されている。本講演ではシリコンの基礎をふまつつ、弊社の樹脂用添加剤とその利用分野について紹介する。
- 10:15~11:35 **[特別講演]** **次世代自動車の普及に向けて**
経済産業省 荒井 次郎 様
世界的エネルギー環境制約の強化を受けて、各国政府・自動車会社とも、EV や PHEV などの次世代自動車の普及に向け精力的な取組をしている。こうした状況を踏まえ、我が国政府における次世代自動車普及に向けた取組と今後の方向性について紹介する。
- 11:35~13:00 **— 休憩（昼食及び展示会見学） —**
- 13:00~14:20 **[特別講演]** **鉄道におけるスーパー繊維の新しい応用可能性**
鉄道総合技術研究所 上條 弘貴 様
高強度・高弾性率なスーパー繊維は、耐熱性・難燃性、線膨張係数が負などの高い機能性を有する繊維があり、さまざまな応用の可能性がある。鉄道でも、耐震補強材料などとして応用例もあるが、さらに温度による伸縮が問題となる長尺な電線、トロリー線材料や、絶縁性を有した放熱材料など、新しい応用の可能性が考えられるので紹介する。
- 14:20~14:35 **— 休憩 —**
- 14:35~15:15 **[一般講演]** **‘FOWLP Next Stage’ モールディング技術の最新動向**
アピックヤマダ株式会社 中村 貴寛 様
新型スマートフォン iPhone7 の AP (アプリケーションプロセッサ) に、初めて FOWLP (Fan Out Wafer Level Package) が採用された事で注目を集めている。また FOWLP のパワーデバイスへの採用も進んでいる。FOWLP の本格離陸により、部材・装置業界にもたらす新たな商機について紹介します。



電気・電子材料技術セミナー Insulation 2016 併設展示会

— ユーザーと共に歩む電気機能材料工業会 —

昨年に引き続き、電気・電子技術セミナーInsulation 2016 に併設して、当工業会会員企業及び技術セミナー講演団体、会員外団体による新技術、新製品等の展示会を開催いたします。特に、ユーザー様、素材メーカー様におかれましては情報の収集だけでなく、絶好の商談の機会になります。電気・電子技術セミナーをご聴講の際には、ぜひともお立ち寄りください。

なお、併設展示会の見学は、電気・電子技術セミナー聴講者及び「展示招待券」持参の方に限らせていただきます。

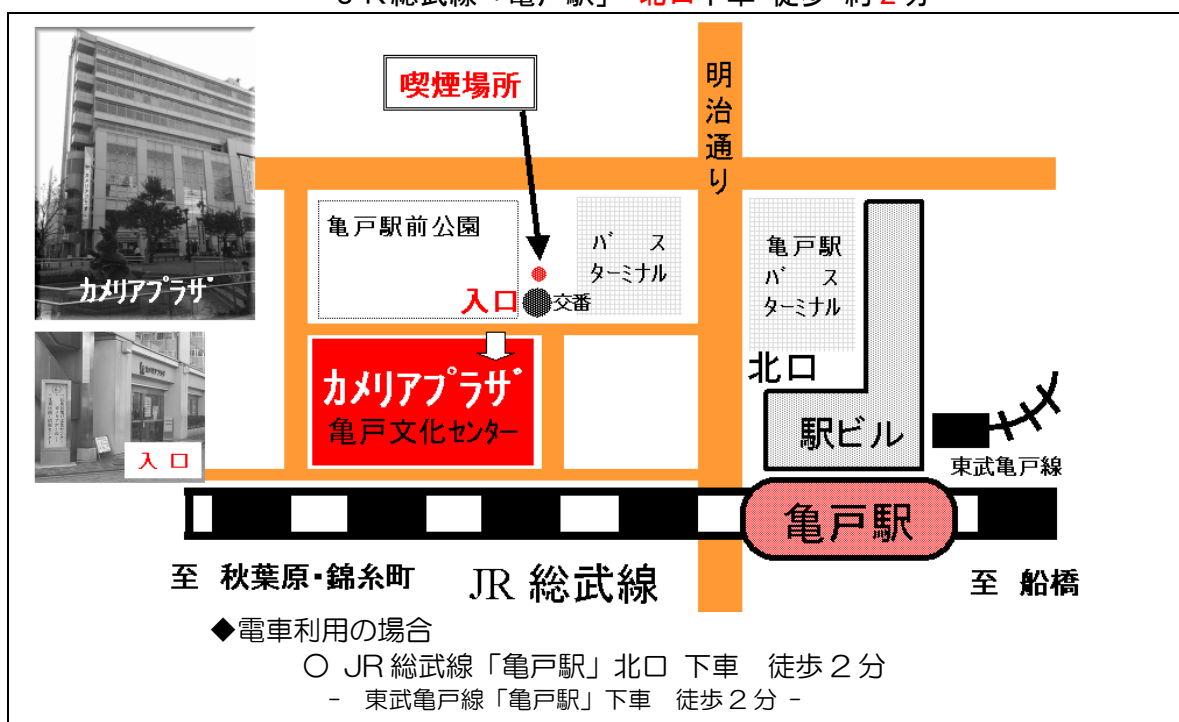
また、昨年好評でした無料懇親会を 11 月 24 日(木)17:00 から 18:00 まで開催いたします。こちらもお参加ください。

*** 会場案内図 ***

技術セミナー：カメラアプラザ 3階・カメラアホール
併設展示会：カメラアプラザ 2階 大研修室

〒136-0071 東京都江東区亀戸 2-19-1 亀戸文化センター
http://www.kcf.or.jp/kameido/kameido_map.html

JR総武線「亀戸駅」北口下車 徒歩 約2分



会場は、**禁煙** です。

建屋前の公園 **喫煙場所** (交番裏) で、お願いします。

*** JR 亀戸駅北口改札口を出て左側へ。

カメラアホール専用入口 (エスカレーター) にて **3階または2階** へお越し下さい。***